

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-72

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	国泰基金、招商证券
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭
时间	2024年11月29日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司主营业务基本情况。</p> <p>公司专注于电子互联领域，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局，印制电路板与封装基板业务“技术同根”，电子装联与印制电路板业务“客户同源”，三项业务在各自领域相继拓展的同时，高效协同共筑起公司电子电路互联技术能力平台。公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，能够为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。业务产品下游应用广泛，拥有较为深厚的行业积淀和扎实的客户基础。从2024年上半年看，PCB业务占公司营业收入约58%，封装基板业务占营业收入约19%，电子装联业务占营业收入约15%。</p> <p>Q2、请介绍公司在封装基板领域的布局情况及当前能力水平。</p> <p>公司自2008年以来对封装基板业务进行孵化，从细分领域产品做起，是中国封装基板</p>

领域的先行者。如今，公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司目前已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力，并与多家全球领先厂商建立了长期稳定的合作关系，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。另一方面，针对 FC-BGA 封装基板产品，公司通过近年来持续的技术研发工作，已实现部分产品的技术能力突破，相关客户认证及产能建设工作取得进展。目前，公司已成为内资最大的封装基板供应商。

Q3、请介绍公司无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。

公司无锡基板二期工厂于 2022 年 9 月下旬连线投产，目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年持续快速提升，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作，其认证周期相较其他 PCB 及封装基板产品所需时间更长。

Q4、请介绍 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。

伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，新一代信息技术产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求均受到上述趋势的影响。

Q5、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。

公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。

Q6、请介绍公司 PCB 业务后续扩产规划。

公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，已在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设有序推进中，具体投产时间将根据后续建设

	<p>进度、市场情况等因素确定。另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。</p> <p>Q7、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 及封装基板工厂稼动率较第二季度变化情况。</p> <p>公司 2024 年第三季度 PCB 工厂稼动率环比基本持平，维持在高位水平；封装基板工厂稼动率随下游部分领域需求波动略有回落。</p> <p>Q8、请介绍公司 2024 年第三季度营业收入及综合毛利率环比变化情况。</p> <p>2024 年第三季度，公司营业收入 47.28 亿元，环比增长 8.45%，主要由于电子装联业务项目结算增加影响，营收规模环比增加。公司综合毛利率环比略有下降，一方面由于电子装联业务规模增长（因业务形态特点，其毛利率一般略低于公司综合毛利率）；同时封装基板及 PCB 业务受产品结构变化影响，业务毛利率环比下降。此外，广州封装基板新工厂产能爬坡、原材料涨价对第三季度综合毛利率也造成一定负向影响。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>